

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-28

Skrócona nazwa emitenta  
MODULE TECHNOLOGIES S.A.

Temat

Przydział obligacji imiennych serii J oraz K

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Module Technologies SA („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r., dokonał przydziału obligacji imiennych serii J o łącznej wartości, zarówno nominalnej jak i emisyjnej, 3 023 000 zł (trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych). O zamiarze emisji obligacji serii J Spółka powiadamiła w raporcie bieżącym EBI nr 27/2019 z 07 czerwca 2019 r.

Przydział nastąpił na rzecz 36 podmiotów (osób fizycznych) w trybie określonym w art. 33 pkt 2) ustawy z 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Obligacje podlegać będą wykupowi po okresie 36 miesięcy od dnia emisji (rozumianego jako dzień przydziału obligacji), będą oprocentowane w wysokości 8,25 procent w stosunku rocznym, płatność odsetek będzie następowała w kwartalnych okresach odsetkowych.

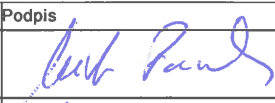
Ponadto Spółka w dniu 28 czerwca 2019 r. dokonała przydziału obligacji imiennych serii K o łącznej wartości, zarówno nominalnej jak i emisyjnej, 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych). O zamiarze emisji obligacji serii K Spółka powiadamiła w raporcie bieżącym EBI nr 28/2019 z 26 czerwca 2019 r.

Przydział nastąpił na rzecz 5 podmiotów (4 osób fizycznych oraz jednej osoby prawnej) w trybie określonym w art. 33 pkt 2) ustawy z 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Obligacje podlegać będą wykupowi po okresie 36 miesięcy od dnia emisji (rozumianego jako dzień przydziału obligacji), będą oprocentowane w wysokości 8,25 procent w stosunku rocznym, płatność odsetek będzie następowała w kwartalnych okresach odsetkowych.

MODULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
MODULE TECHNOLOGIES S.A.		Usługi inne (uin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
43-300	Bielsko-Biała		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Hugona Kołtąja		14/6	
(ulica)		(numer)	
+48 32 210 18 26		+48 32 210 18 26	
(telefon)		(fax)	
zarzad@lstechhomes.com		www.lstechhomes.com	
(e-mail)		(www)	
5472105335		241140645	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-06-28	Mirosław Pasieka	Prezes Zarządu	
2019-06-28	Leszek Surowiec	Wiceprezes Zarządu	